5 3 2 1

封面

本	说明	日打		BUG
10	1. init	2023	2-05-17	

原理图索引

页码	说明						
-	COVER						
2	SYSTEM B	LOCK					
3	MCU						
	Г		工程名称				
			工程名称 HY_CEPRI_TEST_V10_220517	设计:	年	月	H



程名称 HY_CEPRI_TEST_V10_220517	设计:	年	月	H
!纸名称				
01 COVER	审核:	h		н
期 Wednesday, May 18, 2022	甲似.	年	月	H
码 1 总页码 3	审批:	h:		н
纸大小 A3 版本 V10	1 申1ル.	年	月	H

主板 ADUCM4050 SPI ADF7023 IIC 传感器板 TMP117

3

